



最大额定值 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )

参数名称	符号	数值	单位
工作电压	V <sub>CC</sub>	6.0	V
存储温度	T <sub>stg</sub>	-65 to +150	°C
输入电压		-0.3 to +(0.3+V <sub>CC</sub> )	V
功率消耗	P <sub>D</sub>	见附注1	W
结温度		150	°C
蒸发状态(60 秒)		215	°C
红外线 (15 秒)		220	°C

附注1: 最大功耗取决于三个因素: T<sub>JMAX</sub>, T<sub>A</sub>,  $\theta_{JA}$  它的计算公式  $P_{D\text{MAX}}=(T_{J\text{MAX}}-T_A)/\theta_{JA}$ , 8002的T<sub>JMAX</sub>=150°C. T<sub>A</sub> 为外部环境的温度,  $\theta_{JA}$  取决于不同的封装形式。(SOP 封装形式的为140°C/W)

电特性

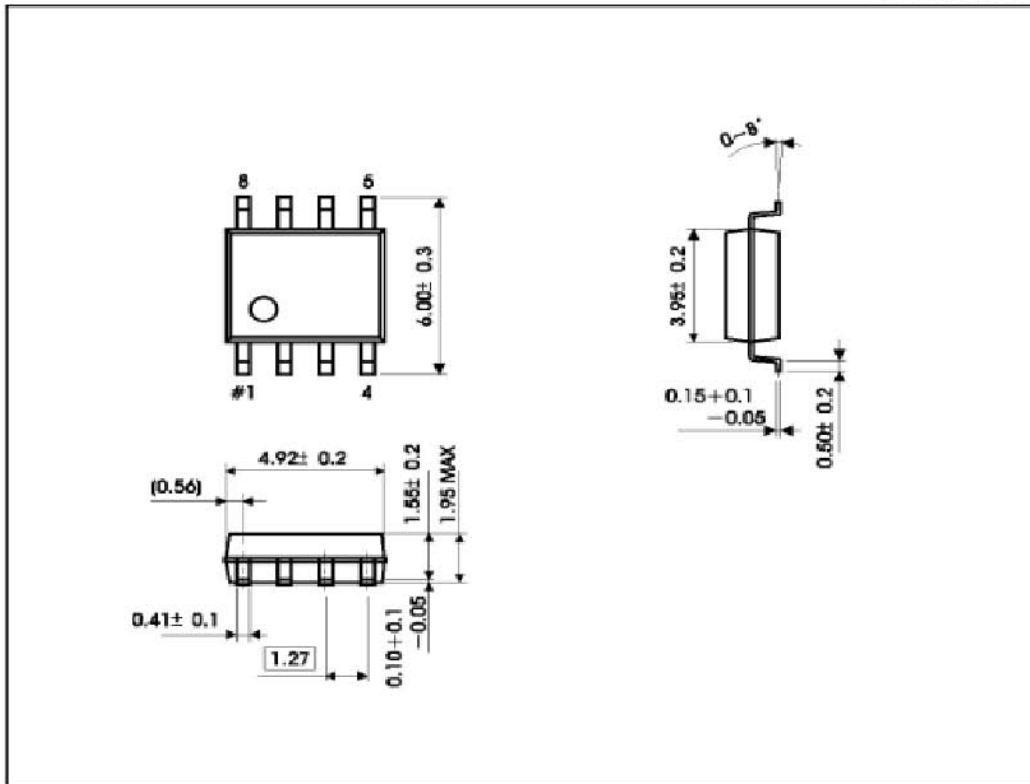
(除非特别说明, V<sub>CC</sub>=5V, f=1kHz, T<sub>amb</sub>=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
工作电压	V <sub>DD</sub>		2.0		5.5	V
静态电流	I <sub>DD</sub>	V <sub>IN</sub> =0V, I <sub>O</sub> =0A		6.5	12.0	mA
关闭电流	I <sub>SD</sub>	V <sub>PIN1</sub> =V <sub>CC</sub>		0.6		μA
输出关闭电压	V <sub>OS</sub>	V <sub>IN</sub> =0V		5.0	50	mV
输出功率	P <sub>O</sub>	THD=1%, f=1kHz, R <sub>L</sub> =8Ω		1.2		W
		R <sub>L</sub> =4Ω		2.0		W
		R <sub>L</sub> =3Ω		2.38		W
		THD=10%, f=1kHz, R <sub>L</sub> =8Ω			1.5	W
		R <sub>L</sub> =4Ω		2.5		W
		R <sub>L</sub> =3Ω		3.0		W
最小谐波失真	THD	f=1kHz, R <sub>L</sub> =4Ω		0.13		%
		R <sub>L</sub> =8Ω			0.25	%
电源失真度	PSRR	V <sub>CC</sub> =4.9V to 5.1V		60		dB

注: \* R<sub>L</sub>=3Ω 时SOP 电路带散热片测试

## SOP-8

unit:mm



## DIP-8

unit:mm

